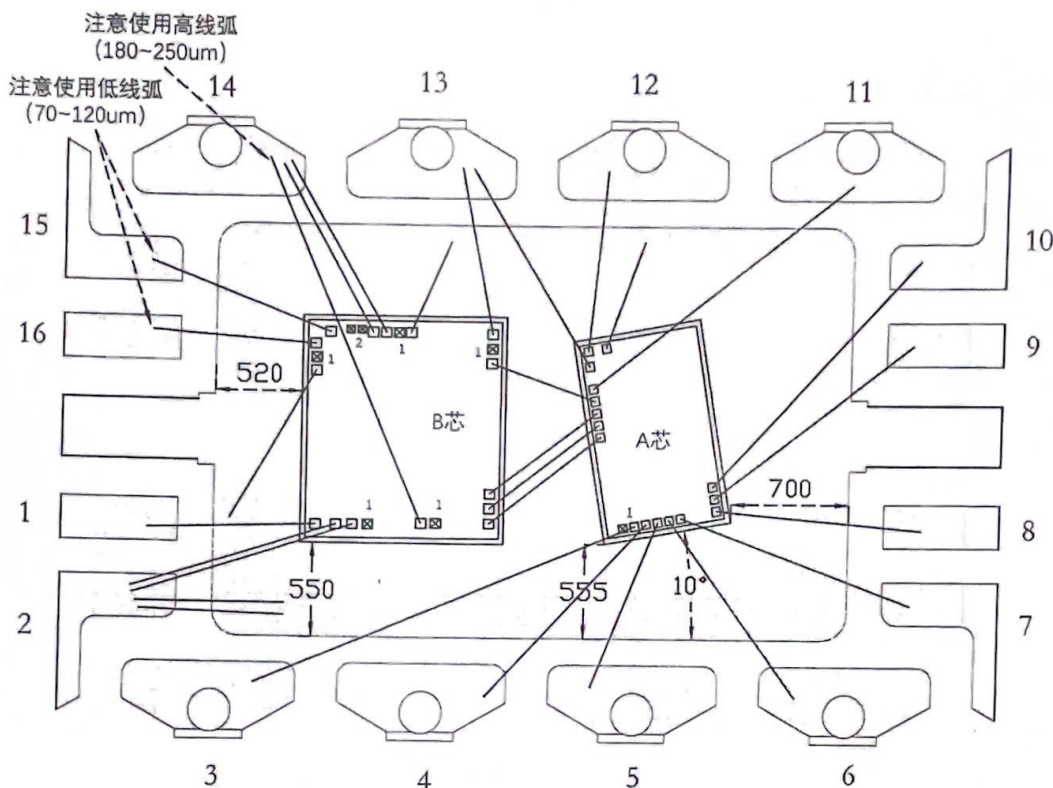
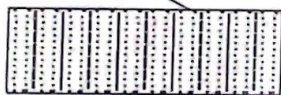
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHIZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD				客户代码 Customer No.	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-754 A	
焊线图 Bonding Diagram				产品名称 Product Type	WL2612		封装外型 PKG Type	SOP16L(12R)
焊线类型 Wire Type	焊线直径(um) Wire Diameter	焊线数量 NO. of wire	焊线总长(um) Total wire length	最长线长(um) Longest wire length	最短线长(um) Shortest wire length	密封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)	LF 载体尺寸 LF Pad Size	
合金丝 Ag	20	29	41442	2555	570	优选(Preferred): CEL-1702HP 备选(Upcomm): EME-G630AY	SOP16L-12R (94*150mil) (2300*3810um ²)	
客户图号 Customer drawing NO.								



椭圆孔
L/F Direction (D/A):



芯片图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
1. 以施工单要求按顺序贴片, 如: 先装A芯片, 装B芯片时必须要在有A芯片的框架, 反之先装B芯片, 装A芯片时B芯片已经贴片;
2. 控制温度, 为WB预留焊线位置;
WB注意:
1. 数字为不打线pad点个数;
2. 植锡点在B芯

说明 Instructions	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BFO (um ²)	最小焊盘间距 Min BFP (um)	铜垫厚度(um) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片道宽度 Street line (um)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否无 Leadless (Pinless)	减薄厚度 (um) Wire Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conducity) S210	HSS159	1135*709(um ²) 44.69*27.91(mil ²)	50*50	70	0.8	是/Yes	60	8	否/NO	200
B芯: DIE B	导电胶 (conducity) S210	WL1710	1165*1259(um ²) 45.67*49.57(mil ²)	62.05*56.1	70	3.4	是/Yes	60	8	否/NO	200
C芯: DIE C											
编制 Prepared by	陈林 2024.4.27		制图日期 Create Date	2024/4/27		生效日期 Effective Date					
研发审核 R&D Check	陈林 2024.4.27		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by					

温馨提示: 本图作为生产下线的唯一依据, 请认真确认, 我司依据该图生产, 如因该图设计产生不可估量损失, 谢谢!
Warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce inestimable loss. Thank you

客户确认签字/盖章:
Customer Signature

2024.4.28